HEAT PIPE CONNECTOR

Patent number:

JP53136749

Publication date:

1978-11-29

Inventor:

OGISO KEN; others: 01

Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

Classification:

- international:

F28D15/00; F28F9/26

- european:

Application number:

JP19770050675 19770504

Priority number(s):

Abstract of **JP53136749**

PURPOSE:To make inside of connecter heat pipe structure and to connect number of heat pipe cooling ends and heating ends with low temperature resistances in series.

(9日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-136749

⑤Int. Cl.²F 28 D 15/00F 28 F 9/26

識別記号

墾日本分類 69 ℃ 3

庁内整理番号 7038--3A

砂公開 昭和53年(1978)11月29日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

タヒートパイプコネクタ

②特 願 昭52-50675

②出 願 昭52(1977)5月4日

@発 明 者 小木曽建

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話公社武蔵野電気通 信研究所内

@発 明 者 佐々木悦郎

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話公社武蔵野電気通

信研究所内

切出 願 人 日本電信電話公社1947 理 人 弁理士 小林将高

明 讃 信

1. 発明の名称

ヒートパイプコネクタ

2. 特許請求の範囲

(I) ヒートパイプの冷却増と加熱増とを接続するヒートパイプコネクタにおいて、前配ヒートパイプコネクタの内部をヒートパイプ構造としたことを特徴とするヒートパイプコネクタ。

(2) ヒートパイプコネクタは所要の角度に組織 したものである特許請求の範囲第(1)項記載のヒートパイプコネクタ。

3. 発明の詳細な聪明

この発明は、複数個のヒートペイプの冷却増と 加熱増とを直列に接続する際、その接続部を含わ めて低熱抵抗に構成できるようにしたヒートペイ プコネクタに関するものである。

ヒートパイプは、静状、板状等の容器中にウイ ツクと呼ばれる毛綱管構造を形成し、水、アルコ ールその他の液体を適当量對入し、密閉した構造 を有する伝熱用部品で、その等価的熱伝導率が非

常に大きい(娘の数10倍以上)ことを利用して、 各種美俚,後器等の伝熱,除熱,冷却等に広く応 用されている。ヒートペイプは非常に大きい毎価 的熱伝導率を有するので、ヒートパイプによつて 伝熱路を排成すれば非常に低熱板抗の熱伝道を実 現することができる。しかし、ヒートペイプの勅 果を発揮するためには、 伝ばんした鳥を最終的に 吸収するヒートシンクが必要であり、これは通常、 ヒートペイプの冷却増に 設けられた放船構造によ り、堕冷,液冷等によつて達成される。従つて、 ヒートペイプを適用する対象装置の構造等の適由 により、ヒートペイプの加熱増と最終ヒートシン クとの瓶雕が大きくなると、ヒートパイプの寸法 が長大となり、また恩義した形状となることが多 い。一方。ヒートパイプは現在の大部分の製造工 程によつては、他の放動用部品(放動フイン。送 兵後等) に止して、重量あたりあるいは体積あた りの価格が大きく。長大寸法あるいは昼曲形状の ヒートパイプの使用は、美量価格の上昇をもたら すこととなる。そのため、従来伝熱路が長大ある

特認問53-106749(2)

いは国由した形状となるときは、小寸去のヒート パイプの複数個を、加熱期と冷却増とを金属のカ ラーあるいはフランジ等により、順次に選列に達 結して、必要な長さあるいは影状の伝熱路を構成 していた。しかしこの場合、後編部の熱狂抗を充 分に小さくするために、袋蔵帯を搭装あるいはろ う付け等することは、作業に必要な高温がヒート パイプを損傷するため不可能であり、また後観具 のカラーあるいはフランジに解答の熱伝導性の良 好な材料を用いてねじ等により緊密に締結したと しても、カラーあるいはフランジ等の袋装具の新 関模が小さいこと、ヒートパイプの接触場に空隙 が存在すること等の理由のため、装蔵等の熱抵抗 がヒートパイプ本体の熱抵抗(非常に小さく、ゼ PK近い)に比べて大きく。このため、このよう な方法によつて構成したヒートパイプの伝熱略で は、ヒートペイプの特長を完全に発揮することが できなかつた。これらの例をさらに固貫によつて 説明する。

第1回,第2回は従来のヒートペイプ接続法を

泉するので、ヒーテバイグコネクタとしてカラー およびフランジを用いた的で、第1回(4)。(6)はカ ラーを用いた部分針役因および凝新面因。第2因 は同じくフランジを用いた部分斜視圏および凝断 海図である。これらの図において、1は快観され る一方のヒートペイプ、2は値方のヒートペイプ、 まはカラー、 4, 5は前配ヒートペイプ1, 2を 構成するウイツク、まは前配ヒートパイプ1, 2 の接触機両を連進する熱流、7は何方を連過する 熟達である。また第2回におけるまはフランジで ある。第1屆,第2因において、前の流れは矢印 で示したように接続増高を通過する熱流すと側方 を適適する熟施?によつて熱伝達されるが、ヒー トパイプ1または2の増資の面積のみでは容器増 面の熱抵抗,接触熱抵抗等のため十分大きい熱コ ンダクタンス(熱抵抗の逆散)をとることができ ず、またカラーまあるいはフランジまも、尽さの 剱展のため、ヒートパイプ1,2に対応するだけ の無コンダクタンスをとることができず。このた め。接着部の熱抵抗を十分小さくすることができ

ない。

この発明は、上配従来の欠点を輸去するために なされたもので、内部にヒートパイプ構造を有す ることを特徴とするヒートパイプコネタタであつ て、その目的は接続すべき複数のヒートパイプの 冷却増(放船増)と加船増(受船増)とを十分に 低い熱低抗で連結することによつて、小寸法のヒ ートパイプから長大あるいは風曲した形状の低熱 紙抗伝熱路を義済的に実現することにある。以下 この発明について説明する。

第3図(a)~(d)はこの発明の一実施例を示するの で、第 8 図(x)はヒートパイプを連結した状態の斜 祖図、第3図(b)は第3図(a)の縦断画図。第3図(c) ``` は第3図(b)のA-A線による新画図、第3図(d)は 第3図(c)の部分拡大斯画図である。これらの図で 1は円形新園のヒートペイプで、1Aはその冷却 様(放熱煤)、2は前配ヒートパイプ1に退留さ れるヒートパイプ、2点はその加熱増(受熱増)、 11はヒートパイプコネクタであり、このヒート パイプコネクタ11は2個の半個片からなつてい

る。すなわち、12は一方の半円筒状の半個片、 13は前記半個片12と対をなす半円筒状の半個 片で、これら半個片12,18はそれぞれ両側に 一体に取り付けた締結用金具部14,18で、と の両者をポルト18およびナット17によつて舞 結し、ヒートパイプ1,2が連載される。18は **前配ヒートパイプコネクタ11を構成する半個片** 1 2, 18のそれぞれの内部に存在するウイツク、 1まは首配ヒートパイプコネクタ11とヒートパ イブ1,2の後放歩に介在させた軟質金属シート。 20は前配ヒートペイプ1および2の冷却増1人 および加熱増2Aを通過する熱流、21は前配ヒ ートペイプコネクタ11を構成する半個片12, 13内のウイツク18を選出する熱流である。

次に熱伝達作用について説明すると、まず、ヒ ートパイプ1の冷却増1Aに達した熱は、ヒート パイプ増画を通過するほか。ヒートペイプコネク メリリの加熱堆(半個片12。13のヒートパイ ブ1舞)→同じく冷却増(半個片12。18のヒ トペイプ2舞)→ヒートペイプ2の加熱増2Aと

いう日島で見れる。このとき、介在する数質支具 シート1まとよつでヒートパイプコネクタ11と ヒートパイプ1、2の装魚品の空間は除去され影 伝達効率は上昇する。

いまヒートペイプ選挙、寸なわち冷却増1五ま たは加島増2人の有効半径をで。 ヒートパイプコ ネクター1、すなわち半個片12,13の有効原 さ(半径方向)をもとすると、(ヒートペイプコ ネクタ有効新菌費)/(ヒートペイプ有効新菌費) 中2 x r・ t / x r² = 2 t / r 。 となるので 厚さしをある彼以上にすれば(モディノ2)。面 **費比は充分1に近くとれるが、厚さtをあまり大** きくすることは。ヒートペイプコネクタ11の外 任を大きくすることになるので、厚さしの値には 展度があるが、歯積比が1より小さくなつても、 ^ ヒートパイプ増資を連過する熱量もかなりあり。 またヒートペイプコネクタ11の有着調費が小さ くても、内幕を進動する液体、蒸気波量が増すこ とにより、等価的熱コンダクタンスが増すので、" これらの効果により接続部の熱証抗が増加するこ

特別図53-135743(3) こはない。またビードパイプでネフタと1と、各 ビードパイプ1、1との接触面側は、十分大きく とることができるので、この部分の熱量就は十分 小さくできる。

第4回はヒートパイプコネクタ11とヒートパイプ1,2とを推結するための他の実施例で、2 つ割り構造のヒートパイプコネクタ11を構成する半個片12,13の一方の合せ部をヒンジ22 を用い、他方の合せ部をクランプ23を用いてヒートパイプ接続部を構成したものである。

上記したような縁成によるヒートペイプコネタ タ11を複数保層いることによつて、複数値の小 寸法ヒートペイプの冷却増と加熱値とを順次直列 に連結できるので、長大寸法あるいは豊産した形 状のヒートペイプ伝熱略を経済的に構成すること ができる。

第 5 図(a)。(b)はこの分別の他の実施例を示す後 統部の斜複関および新面図で、そ方形新面のヒー トパイプゴ。 2'を第 5 関(b)に示すようなヒートパ イプコネクタ1 1 で接続したものである。すなわ

ち、斯面が長方形をなす半個片 1 2'。 1 2'を用いてヒートペイプコネクタ 1 1 を形成したものである。なお、第 5 因では連結会具郷は貨略してある。

第6間(a), (b)はこの発明のさらに他の実施例を示す斜視関で、任意角度に開曲した斯南か 長方形 および円形の半個片 1 ヹ゚, 1 8 だよつてヒートパイプコネクタ1 ギを構成し、これによつてヒートパイプ1, 2 を接続したものである。この場合、ヒートパイプ1, 2 の畑部は管着させないでも、ヒートパイプコネクタ1 ゼ により十分に貼伝達を行うことができる。

第7回はこの発明の応用例を示すもので、電子 計算機等の発熱する電子部品まを高密度に搭載し た装置において、印刷記線回路ペッケージの冷却 用にヒートペイプを装着し、これにこの発明によ るヒートペイプコネクタを用いて、複数 個のヒー トペイプを解次連結して低熱板状の放熱級路を維 成したものである。図の10は印刷配線板を示す。

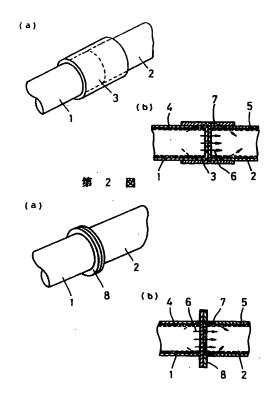
なお、上配各実施例では、ヒートパイプコネク タを構成する個片は2分割したいわゆる半個片を 用いたものについて既朝したが、この発明はこれ に限定されるものではなく、一体に形成した単一 のものあるいは3個以上に分割したものでもよい ことはいうまでもない。

以上説明したようにこの発明は、内部にヒート パイプ構造を有するヒートパイプコネクタを用い てヒートパイプの冷却娘と加熱機とを連結するよ うにしたので、十分低い熱症抗の接着部を実現す ることができ、かつこのヒートパイプコネクタを 用いれば小寸法の複数のヒートパイプを組次接額 して長大寸法のヒートペイプ伝動的を構成すると とができる。さらにヒートパイプコネクタを所定 の角度に風歯したものを併用することにより。任 意の形状のヒートパイプ伝熱路を構成することが できる。またヒートパイプの斯画形状に合わせて ヒートパイプコネクタを構成することにより、円 形斯嶺, 長方形斯竇以外の斯竇形状のヒートパイ プでも容易に連結することができ、各種英量の伝 熱,放熱。冷却を経済的に遺成することができる などの利点がある。

4. 国国の競単な説明

因中、1,2はヒートパイプ、1点は冷却地、 2点は加熱地、11はヒートパイプコネクタ、1 2,13は半個片、18はウイツク、28,21 は熱値である。

化黑人 小 林 梓 寅



第1図

